



新聞稿



Wacom、意法半導體和 CEVA 合作提升數位筆使用體驗

- 本次合作為數位筆帶來先進的 3D 手勢、游標和動作控制功能，解鎖大量新應用和便利性
- 正在開發功能完整的參考設計，以協助 OEM 廠商為平板、手機、筆電、互動式白板等產品開發品牌體感數位筆

【台北訊，2022 年 4 月 6 日】—無線連線技術、智慧感測技術和整合 IP 解決方案的市場先驅、意法半導體授權合作伙伴 [CEVA](#)（那斯達克股票代碼：CEVA），與服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商 [意法半導體](#)（紐約證券交易所代碼：STM），以及全球數位筆技術和重要的創新者 [Wacom](#) 宣布合作開發新無線感測器模組，將數位筆的功能擴大到先進的手勢、游標和動作控制層級，提升使用者體驗。合作三方將利用各自的專業技術開發搭載先進感測器的數位筆，OEM 廠商可以利用這種數位筆提升智慧型手機、平板電腦、筆電、個人電腦、互動式白板或其他智慧顯示裝置的產品價值。

「Active ES®（AES）Rear IMU Module」整合 Wacom 數位筆技術與意法半導體的客製化版 [低功耗 6 軸慣性測量單元感測器](#)和 [藍牙低功耗系統晶片（SoC）](#)，以及 CEVA 的 [MotionEngine™ Air](#) 動作控制軟體，是一個低功耗的高功率配置數位筆解決方案，可整合到任何外形尺寸的數位筆中。模組支援動作指向、手勢控制和 3D 動作追蹤。OEM 廠商可以自定義修改模組參考設計，以完成一系列新應用、使用者便利性和功能。這款感測器數位筆還可當作會議簡報無線控制器，透過自然的手部動作控制游標在螢幕上移動，還可以透過一個手勢代替一系列複雜的選單和點擊指令。該軟體採用 CEVA 的方位補償和自適應震顫消除專利技術，確保在各種應用領域提供高度一致的直觀使用者體驗。

Wacom 率先推出具備這些進階功能的 AES Pen 數位筆。AES Rear IMU 模組的目標應用是隨插即用的模組附件，透過適用的模組介面與 Wacom 的 AES 數位筆無縫協同運作。使用 AES Rear IMU 模組感測器可顯著提升工作效率，簡化商務人士、學生等不同使用者的作業流程。AES Rear IMU 模組支援使用者以自然手勢動作遙控裝置，將從前的個人體驗變成共享協作的使用感受。

Wacom 技術解決方案業務部執行副總裁 Sayatake Komine 表示，「我們一直在尋求改善客戶的數位筆使用體驗，我們與 ST 和 CEVA 的合作多方面擴充了數位筆的功能。手勢、指向和動作控制創造了一個自然真實的使用者界面，完美地補充了我們的數位筆功能，AES Rear IMU Module 模組還可以將感測器功能應用無縫增加到 AES 系列數位筆中。」

意法半導體消費 MEMS 業務部總監 Simone Ferri 則表示，「隨著使用範例創新，可安裝在筆內的技術越來越多，數位筆採用率正以驚人的速度成長，而且成長態勢將會繼續維持下去。我們 IMU 感測器的精度和小尺寸，以及 BLE SoC 晶片非常適合在數位筆內整合感測器和連線功能，而參考設計可以讓更多 Wacom 客戶使用這些技術。」

CEVA 感測器融合業務部副總裁暨總經 Chad Lucien 進一步表示，「我們很高興能與 Wacom 和 ST 合作，將 MotionEngine™ Air 軟體導入數位筆市場。我們軟體程式容量不大，能夠在 BLE MCU 上執行，為動作感知應用提供無與倫比的識別精度和控制功能。這款創新產品是我們三方合作的成果，確保 OEM 廠商獲得生產級設計，在應用層級客製化軟體，實現體感數位筆設計的差異化。」

您可在 <https://youtu.be/4HpPTjFlqBk> 觀賞體感數位筆的先進功能介紹影片。

關於 Wacom

Wacom 成立於 1983 年，是一家總部位於日本的全球性公司，在世界各地設有子公司和相關公司，在 150 多個國家地區設立行銷業務辦事處，是世界排名前列的數位板、互動式數位顯示器和數位介面解決方案供應商。Wacom 直觀輸入裝置的先進技術創造了激動人心的數位藝術、電影、特效、時裝和設計，並為商業和家庭使用者提供領先的界面技術，以表達其個性。該公司還為服務於增量市場的領先製造商提供 OEM 解決方案。Wacom 的界面技術稱之為 Wacom Feel IT 技術，透過整合解決方案的方式提供給策略合作夥伴。大多數平板和 PC 製造仰賴這項先進功能和可靠性，提供卓越的使用者界面體驗。更多關於 Wacom 的資訊，請造訪：www.wacom.com。

關於意法半導體

意法半導體擁有 48,000 名半導體技術的創造者和創新者，掌握半導體供應鏈和先進的製造裝置。作為一家獨立的半導體裝置製造商，意法半導體與逾二十多萬客戶、數千名合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同打造生態系統，一同攜手因應各種挑戰和新機會，滿足世界對永續發展的更高需求。意法半導體的技術讓人們的出行更智慧、電力和能源管理更高效、物聯網和 5G 技術應用更廣泛。意法半導體承諾將於 2027 年實現碳中和。詳情請瀏覽意法半導體官方網站：www.st.com。

關於 CEVA

CEVA 是排名前列的無線連接和智慧感測技術，以及整合 IP 解決方案授權商，旨在打造更智慧、更安全、互聯的世界。為感測器融合、影像提升、電腦視覺、語音輸入和人工智慧應用提供數位訊號處理器、人工智慧引擎、無線平台、加密內核心和配套軟體。這些技術與其 Intrinsic IP 整合服務一起提供給客戶，協助他們解決複雜和時間關鍵的整合電路設計專案。許多世界排名前列的半導體商、系統公司和 OEM 廠利用我們的技術和晶片設計能力，為行動、消費、汽車、機器人、工業、航天國防和物聯網等各種終端市場開發高效能、智慧，而且安全的連網裝置。

我們基於 DSP 的解決方案包括行動、物聯網和基礎設施中的 5G 基頻處理平台；相機裝置的進階影像技術和電腦視覺；適用於多個物聯網市場的音訊 / 語音 / 話音應用和超低功耗的始終開啟 / 感測應用。對於感測器融合，Hillcrest Labs 感測器處理技術為耳機、穿戴式裝置、AR / VR、PC、機器人、遙控器、物聯網等市場提供廣泛的感測器融合軟體和慣性測量單元 (Inertial Measurement Unit · IMU) 解決方案。在無線物聯網方面，我們的藍牙 (低功耗和雙模)、Wi-Fi 4 / 5 / 6 / 6E (802.11n/ac/ax)、超寬頻 (UWB)、NB-IoT 和 GNSS 平台是業界授權較為廣泛的連線平台。

請造訪：www.ceva-dsp.com，並在 [Twitter](#)、[YouTube](#)、[Facebook](#)、[LinkedIn](#) 和 [Instagram](#) 關注我們。